

# 性 能 表

品 名	LPC シリーズ基板ディップタイプ雌コネクタ	製品番号	LPC-( )FDSG+, FDG+ (全めっき, RoHS 品)
適用・引用規格			
定 格	電 圧	AC- <del>100</del> 125V	
	電 流	1A	
	温 度	-25℃ ~ +85℃	
	湿 度	相対湿度 90%以下	
適合コネクタ (RoHS 品)	LPC-( )M2G, TIM2G, M2LG, MB2G 等		

## 特 性

No	項 目	条 件	認定試験	製品検査
1	構造・形状・寸法	付図及び適用・引用規格に適合すること。	○	○
2	材料・仕上・表示	同 上	○	○
3	かん合性	適合コネクタと異常なくかん合すること。	○	○
4	絶縁抵抗	DC500V で測定したとき 1000MΩ 以上	○	○
5	耐電圧	AC500V (実行値) を 1 分間印加して絶縁破壊のないこと。	○	○
6	接触抵抗	YHP4328A にて測定して 20mΩ 以下	○	—
7	挿抜力	单体 □0.5mm の鋼製ゲージにて 挿入力 1.96N 以下 抜去力 0.196N 以上	○	—
		総合 適合コネクタとかん合 挿入力 1.96N×芯数 以下 抜去力 0.196N×芯数 以上	○	—
8	耐振性	周波数 10~500Hz, 振幅 1.52mm, 加速度 98m/s <sup>2</sup> にて試験後、割れやゆるみのないこと。	○	—
9	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> にて試験後、割れやゆるみがないこと。	○	—
10	繰り返し動作	適合コネクタにて繰り返し 50 回挿抜した後、接触抵抗 30mΩ 以下を満足すること。	○	—
11	温度サイクル	-25℃~+85℃にて試験後、割れ等の異常のないこと。	○	—
12	耐湿性	温度 40±2℃, 相対湿度 90~95%, 時間 96H にて試験後、4 項 絶縁抵抗, 5 項 耐電圧, 接触抵抗 30mΩ 以下を満足すること。	○	—
13	塩水噴霧	5%塩水, 時間 48H にて試験後、接触抵抗 30mΩ 以下を満足すること。 また、はなはだしい腐食のないこと。	○	—
14	硫化水素ガス	温度 40℃, 濃度 3ppm, 時間 96H にて試験後、接触抵抗 30mΩ 以下を満足すること。 また、はなはだしい腐食のないこと。	○	—
15	高温放置	温度 85℃, 時間 96H にて試験後、7 項 挿抜力, 接触抵抗 30mΩ 以下を満足すること。 また、割れ等の異常のないこと。	○	—
16	温度上昇	適合コネクタとかん合し、全コンタクトをシリーズに結線し、1A を通電したときの温度上昇は 30℃ 以下のこと。	○	—
17	半田付け性	半田温度 245℃ 中に 5 秒間浸漬後、半田の濡れ面積が 95% 以上のこと。	○	—
18	半田耐熱性	260℃ の半田槽に 10 秒間浸し、外観に異常がないこと。	○	—
19	耐洗浄性	イソプロピルアルコールにて浸漬洗浄後、外観に異常がないこと。	○	—
20	コンタクト保持力	雌コネクタ絶縁物のコンタクト固定力 4.9N 以上	○	—

備 考 (半田付作業の注意事項)  
手半田の場合は、370℃ 以下のコテで 5 秒以下とし、コテ先でコンタクトに負荷を加えないようにして下さい。

					承 認		検 図		検 図	—	作 成	
△	年月日	変更者	変 更 内 容	承 認	本多通信工業株式会社			作成 2004 年 8 月 9 日				